

新年のご挨拶
本年もよろしくお願い申し上げます

皆様には平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年を振り返りますと、ロシアによるウクライナ侵攻の継続やイスラエル・パレスチナ紛争、アサド政権の崩壊など、国際情勢が緊迫した状況が続いた一方で、米国をはじめ、多くの国や地域で大統領選挙や総選挙が行われた「選挙イヤー」でもありました。このような情勢の中、為替、物価、金利などの変動も大きく、先行きの不透明感が一層強まる一年となりました。しかし、国内経済に目を向けると、数十年ぶりの高水準となった設備投資や賃上げなど前向きな動きも見られ、日経平均株価は初めて4万円台を記録しました。

このような状況の中、当社グループの上期業績は生成AIの普及・拡大によるデータセンタ投資の活況により、情報通信事業部門の営業利益が前年同期比で167%と大きく伸長しました。また、自動車事業部門、エレクトロニクス事業部門、エネルギー事業部門も期初計画を上回り、売上高、営業利益、経常利益は過去最高となりました。下期については、厳しい環境が予想されるマーケットもありますが、データセンタ向けの力強い需要

が継続すると見込んでおり、期初の計画を上方修正しました。この結果、2024年度の業績見込みは売上高8,800億円、営業利益1,040億円、経常利益1,030億円、当期純利益620億円となり、これらの数値はいずれも過去最高を更新する見込みです。

2025年は当社にとって140周年を迎える節目の年となります。1885年に絹・綿巻線製造を開始して以来、各時代の社会課題に応え、新たな製品・技術を生み出すことで今日に至るまで事業を拡大してきました。これはひとえに当社をご愛顧頂きましたお取引先様、そして当社の発展に尽力頂いた先人達と現従業員ののおかげであり、心より感謝申し上げます。これからの時代も、新しいことに挑戦する「進取の精神」と、高度な技術を探求する「技術のフジクラ」をDNAに、顧客の価値創造と社会に貢献することで、当社グループを未来ある高収益企業にすべく挑戦していく所存です。

本年もフジクラニュースを通じて、当社グループの技術や製品情報を紹介してまいりますので、皆様の変わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願いいたします。

取締役社長 CEO
岡田 直樹



タワー型ベーパーチャンバの開発

当社はデータセンタにおけるCPU/GPUの高性能化・高密度化による発熱対策、また多岐にわたるご要望に応えるため、空冷式のタワー型ベーパーチャンバを開発しました。

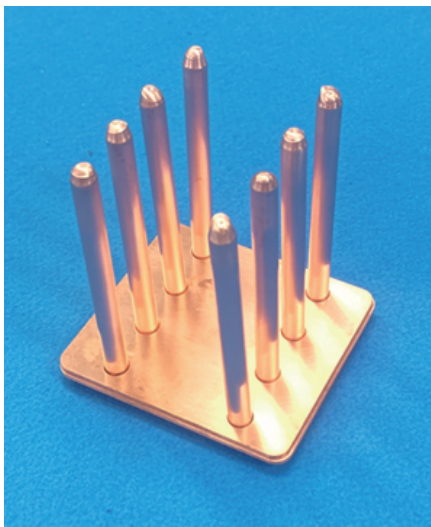
タワー型ベーパーチャンバは、従来の平板状のベーパーチャンバの上面に円柱状のパイプを一体化し、内部空間を連結した構造で、円柱部には放熱フィンが取り付けられています。ベーパーチャンバ内部には作動液が封入されており、熱源の熱により蒸発し、蒸気となって円柱内を上昇し、フィンで冷却されて液体に戻ります。気体と液体へ繰り返し変化しながら内部

を循環することで潜熱を輸送し、大容量の熱を短時間で広い範囲に拡散し、放熱することが可能となります。

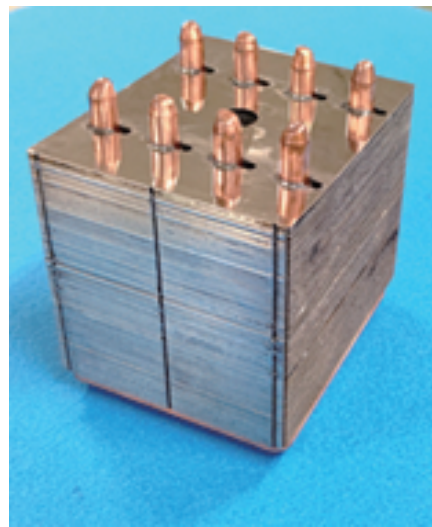
本開発品は、銅板とヒートパイプを組み合わせた従来のタワー型空冷ユニットと比較して15%の熱抵抗低減を実現し、水冷設備の無い既設データセンタにも使用可能な空冷式で、水冷式の冷却効果に比肩する性能向上を果たしました。

当社は今後も冷却モジュールの高性能化、ラインアップの拡大を通じて、お客様のご期待に応える製品を提供し続けていきます。

■ 図1 タワー型ベーパーチャンバ（フィン取り付け前）



■ 図2 タワー型ベーパーチャンバ（フィン取り付け後）



■SDGs 17目標に該当するポイント

冷却モジュールの高性能化を通じて、環境にやさしい次世代データセンタの発展に貢献していきます。



✉ 電子部品開発部 : netsu-info@jp.fujikura.com

高密度 MP0 コネクタ配線ソリューションの販売開始

データセンタのデータトラフィックの増大を背景にデータ伝送の高速大容量化が進んでおり、多種多様な伝送方式が規格化され導入されています。また、昨今のクラウド設備やAI/ML設備においては、400GB/800GB伝送が採用され、MP0コネクタをインターフェースに採用した伝送機器も広まっています。一方で、データセンタ内の通信設備構築を短期間で構築するニーズも高まっています。

そのような状況下、当社は高密度MP0コネクタ配線ソリューションの販売を開始しました。このソリューションは、当社の光ファイバ技術と多心光コネクタ技術で培った高性能かつ高品質な製品で構成されており、お客様のIT設備を将来に渡り支える光配線システムとなっています。

具体的には、このソリューションは、MP0コネクタを用いた高密度パッチパネルとSWR®/WTC® 細径高密度型光ファイバケーブルを用いたMP0コネクタ付きSWR®/WTC® の製品で構成されており、以下のメリットがあります。

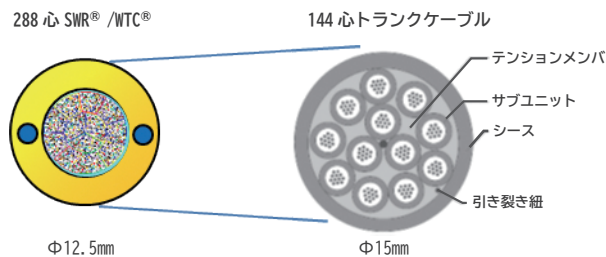
① 軽量化および布設性向上

当社SWR®/WTC® のケーブルを用いることで細径かつ軽量化を実現、ケーブルの取り回しも向上し、布設性も向上、施工容易で光配線における工数・工期の削減に貢献します。

② 運用性向上

高密度のパッチパネルでありながらモジュール引出し機構を設けることで保守・運用性を保ちながらラック収容率を改善します。

*SWR®/WTC® は当社の登録商標です。

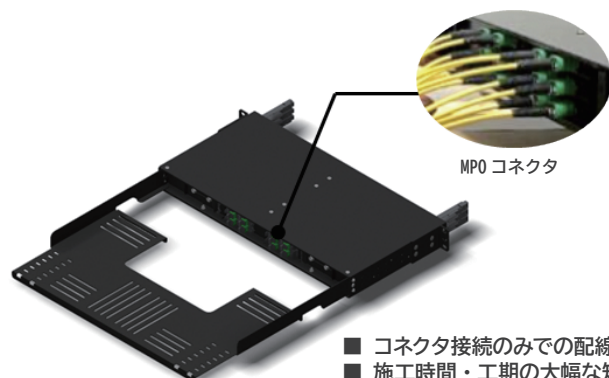


2 倍の心数を 70% のケーブル断面積で実現
(約 3 倍の実装密度)

ケーブルの心数密度比較



MP0 コネクタ付き SM288 心 SWR®/WTC® の構造



高密度 144 心 LC/MP0 パッチパネル (背面側)

- コネクタ接続のみでの配線を構成
- 施工時間・工期の大幅な短縮
- 背面にトレイを接続可能



高密度 144 心 LC/MP0 パッチパネル (前面側)

- モジュールを引き出して、コネクタを容易に挿抜
- 接続したファイバをスムーズに配線

■SDGs 17目標に該当するポイント

当社独自の技術を生かしたソリューションで、ネットワークの高速大容量化に対応した光配線を実現し、安全かつ強靱なインフラの発展に貢献します。



第11回 ウェアラブル EXPO 出展のご案内

日本最大の見本市主催会社であるRX Japan株式会社が主催する「第11回ウェアラブルEXPO -ウェアラブル[開発]・[活用]展-」に当社およびグループ会社の(株)フジクラプリントサーキットが電子部品・コネクタ・FPC関連製品を共同出展します。

ブースにおいては、ウェアラブルデバイスに適した高密度、狭

ピッチ、高速伝送、高アセンブル性、小型・省スペースをキーワードとした電子部品、コネクタおよびFPCを展示します。お客様のニーズに合わせて幅広いラインナップとカスタマイズした高品質の製品を提供します。皆様のご来場をお待ちしています。

第11回 ウェアラブル EXPO

ウェアラブル 開発・活用 展

日時

2025年1月22日(水)～1月24日(金)
10:00～17:00

場所

東京ビックサイト 東8ホール
フジクラグループブース：E80-15

出展詳細サイト

展示会公式サイト



(株)フジクラ出展社詳細



(株)フジクラプリントサーキット出展社詳細



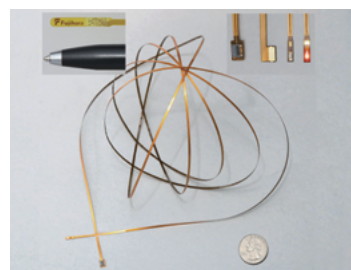
ウェアラブル EXPO- ウェアラブル 開発・活用展



ストレッチャブルメンブレン
伸縮可能な電子回路が形成可能



基板対基板 (FPC) 接続用コネクタ | FB3BA シリーズ
箆合高さ 0.5mm 0.3mm ピッチ
業界最小クラスのコネクタ



極細長尺 FPC
長さ 2m 以上、幅 1mm 以下で
部品実装可、細線対応

■SDGs 17目標に該当するポイント

当社グループは、ウェアラブルデバイスに適したより高品質な電子部品・コネクタ及びFPCの開発を通して、産業技術の革新や発展に貢献します。

